

第一节 重要提示

1. 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2. 本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
3. 公司全体董事出席董事会会议。
4. 立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5. 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司2025年度分配预案为:公司以实施权益分派的股权登记日总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利5.08元(含税),截至2025年12月31日,公司总股本为239,473,466股,本次预计派发现金红利121,662,520.73元(含税),占2025年度归属于上市公司股东净利润的30.02%。
截至报告期末,母公司存在未弥补亏损的相关情况及对公司分红事项的影响
□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

公司简介表,包含公司名称、股票上市交易所、股票简称、股票代码、董事会秘书、董事长、总经理、财务负责人、董事会秘书、独立董事、监事、高级管理人员、联系方式、注册地址、办公地址、邮政编码、电子邮箱、公司网站、经营范围、主营业务、所属行业、上市日期、上市地点、上市板块、上市币种、上市数量、上市费用、上市费用分摊、上市费用承担、上市费用支付、上市费用来源、上市费用用途、上市费用效果、上市费用评价、上市费用改进、上市费用展望、上市费用承诺、上市费用履行、上市费用监督、上市费用考核、上市费用激励、上市费用约束、上市费用保障、上市费用风险、上市费用控制、上市费用管理、上市费用运营、上市费用发展、上市费用创新、上市费用突破、上市费用成就、上市费用贡献、上市费用影响、上市费用意义、上市费用价值、上市费用地位、上市费用作用、上市费用影响、上市费用意义、上市费用价值、上市费用地位、上市费用作用。

2. 报告期公司主要业务简介
功率半导体是半导体分立器件的重要组成部分,主要用于电力设备的电能变换和电路控制,是进行电能处理的核心器件,弱电控制与强电之间的桥梁,细分市场主要有IGBT、MOSFET、BJT等。随着全球“双碳”目标驱动节能减排需求持续升级,功率半导体应用场景已从传统工业控制、4C(通信、计算机、消费电子、汽车)领域,快速渗透至新能源、新能源汽车、轨道交通、智能电网、变频器等领域,成为清洁能源转型与终端产业升级的核心支撑。受益于新能源汽车行业、新能源发电及储能行业需求的快速增长以及AI为代表的兴起行业爆发式增长,功率半导体行业正迎来更多利好叠加的黄金发展期。
2025年,全球汽车电动化进程持续提速,汽车市场稳步增长,新能源汽车成为核心增长引擎。根据EVTank数据,2025年全球汽车销量约9,980万辆,新能源汽车销量2,354.2万辆,同比增长29.1%,其中新能源汽车销量达2,271.1万辆,同比增长27.0%,渗透率约23.5%。根据中国汽车工业协会数据,2025年中国汽车销量3,440万辆,同比增长9.4%,新能源汽车销量达1,649万辆,同比增长28.2%,占全球新能源汽车销量比重达70.3%。中国市场是全球电动化转型的核心引擎,乘用车方面,2025年中国乘用车销量3,010.3万辆,同比增长9.2%,其中新能源汽车销量1,553.7万辆,新能源汽车渗透率达51.6%,功率半导体作为汽车电子的核心器件,是新能源汽车主驱逆变器、车载充电桩、DC/DC转换器、高压系统的不可或缺的核心零部件,新能源汽车的持续快速增长给功率半导体带来广阔的增长空间。

2025年,全球能源低碳转型提速,清洁能源成为全球能源结构升级的核心增长引擎,新能源发电和储能行业持续快速发展。根据IRENA(国际可再生能源署)数据,2025年全球新增光伏装机容量51.1GW,同比增长27.2%,再创历史新高;全球新增风电装机容量15.1GW,同比增长14%;2025年全球新增储能新增装机达到113.3GW/305.8GWh,同比增长52.9%/72.0%。海外清洁能源市场化建设持续推进,储能配套需求快速释放。根据国家能源局官方统计数据,2025年国内新能源产业保持高质量发展态势,全国新增光伏装机容量31.7GW,同比增长14%;新增风电装机容量12.0GW,同比增长15%;中国新增储能新增装机连续四年位居全球首位,2025年新增投运全球储能项目规模达到66.4GW/189.5GWh,同比增长15.9%/72.6%。在全球市场的占比达到58.6%。国内风光储能新增装机规模稳居全球首位,持续引领全球清洁能源转型进程。功率半导体作为能源电力领域的核心器件,广泛应用于光伏逆变器、风电变频器、储能变流器(PCS)等关键设备,是新能源发电与储能系统不可或缺的核心零部件。新能源发电和储能行业的持续快速发展,为功率半导体行业带来广阔的增长空间。

2025年,AI数据中心(AIDC)与算力中心建设规模化提速,新一代算力架构持续升级,工业及机器人、低空/高空飞行器等新应用场景加速落地,构筑了功率半导体行业全新应用赛道。①生成式AI技术快速普及,带动全球高算力需求持续攀升,AI服务器单机功耗、机柜供电密度大幅提升,高压化、高频化、高效率供电成为行业发展趋势。功率半导体作为服务器电源、母线供电模块、能源管理单元的核心基础器件,承担着能效管理、稳压调控、能效优化等关键功能,算力设备的升级迭代驱动着功率半导体器件单机用量与规格升级。②工业及机器人、AI服务器、智能制造转型深化推动工业机器人渗透率持续提升,工业机器人要求高精度、高速度、轻量化控制,大功率驱动、电源管理单元等,机电耦合功率半导体实现电能控制与高效能量转换,行业发展对功率器件的小型化、高可靠、低损耗性能提出更高要求。③低空/高空飞行器领域,电动化、智能化、轻量化发展提速明显,电动飞行器、高空无人机等产品的电机驱动系统、机载电源控制系统,需依托高性能功率半导体保障飞行能效与作业稳定性。整体来看,新兴产业技术革新与场景渗透持续拓宽功率半导体应用边界,下游设备功率等级提升、能效标准升级、电控系统集成化发展,将持续催生刚性需求,为功率半导体行业未来长期发展提供充足增量支撑。

(一) 主要业务、主要产品及用途
1. 主要业务
公司主营业务以IGBT、SiC为主的功率半导体芯片和模块的设计研发、生产及销售,公司总部位于浙江嘉兴,在上海、浙江、重庆和欧洲均设有子公司,并在国内和欧洲均设有研发中心。根据公司《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司所属行业为计算机、通信和其他电子设备制造业,行业代号为“C39”;根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》(2017年修订)《GB/T4754-2017》,公司所属行业为半导体分立器件制造,行业代号为“C3972”。
2. 主要产品及用途
公司长期致力于为高效能、绿色化和智能化应用提供全面的半导体及系统解决方案,产品组合覆盖IGBT、SiC MOSFET、GaN HEMT、快恢复二极管等功率半导体器件以及汽车级与工业级MCU、栅极驱动IC芯片等,广泛应用于新能源、新能源汽车、工业控制与电源、白色家电、AI服务器电源、数据中心、机器人及低空/高空飞行器等领域。2025年,IGBT模块的销售收入占主营业务收入的83.69%,是公司的主要产品。

作为电力电子第三次革命的核心代表,IGBT、SiC和GaN等功率半导体器件被誉为工业控制与自动化领域的“心脏”,承担着电流、电压、频率、相位等关键参数的高效调控。2024年,公司正式成为MCU事业部,专注于高端工控与车规级主控MCU的研发。MCU作为功率半导体的“大脑”,负责信号处理、逻辑判断与系统控制,实现对功率半导体等执行单元的精准调度。而栅极驱动IC则扮演“神经枢纽”的关键角色,负责将MCU发出的控制信号进行放大与调制,以高效、可靠地驱动IGBT、SiC、GaN等功率器件,确保“大脑”指令的准确执行与系统的快速响应。
MCU、功率半导体与栅极驱动IC三者协同,构建起智能化系统中至关重要的“脑?心?神经”协同架构。这一完整产品链弥补了当前国内产业链的关键短板,进一步增强了公司为客户提供系统化解决方案的能力,有助于为下游行业提供更高性能、更低成本、更快速响应的一体化解决方案,尤其在新能源、新能源汽车、机器人、低空/高空经济、AI服务器电源、数据中心等高速增长领域,形成显著的技术协同与竞争优势,为公司持续引领行业创新注入新动能。

(二) 经营模式
公司以市场需求为导向,以技术研发为核心支撑,依托芯片端“Fabless+IDM双轮驱动”的发展模式,实现芯片设计与工艺自主可控,制造柔性布局、资源高效配置;同时发挥模块端自主设计、生产、测试的全流程管控优势,精准匹配下游多元化应用场景,为客户提供具有竞争力的功率半导体器件及配套系统解决方案。
公司产品生产环节主要分为芯片和模块设计、芯片制造、模块生产三个阶段。
阶段一:芯片和模块设计。公司产品设计涵盖IGBT、快恢复二极管、SiC MOSFET等芯片设计与功率模块设计。本阶段,公司根据客户对芯片关键参数的需求,设计符合客户性能要求的芯片;同时,结合客户对电路拓扑、模块结构的需求及功率模块电性能,可靠性地设计满足各行业应用需求的功率模块。

阶段二:芯片制造。目前,公司芯片制造依托“Fabless+IDM双轮驱动”模式。一方面,公司芯片主要委托海外华虹、上海积塔等第三方晶圆代工;另一方面,公司积极投入自主设计研发及工艺制程研发及产业化项目,高规格特色工艺功率芯片研发及产业化项目已完成建设投产,形成年产6万片6英寸车规级SiC MOSFET芯片、30万片6英寸3300V及以上高压特色功率芯片的生产能力。
阶段三:模块生产。模块生产是基于模块原理,将单个或多个功率芯片(如IGBT、快恢复二极管、SiC MOSFET、GaN HEMT等芯片)通过先进封装技术封装于绝缘外壳内的过程。本阶段,公司根据不同产品需求,通过芯片贴片、回流焊接、钎焊成型、全流程测试等核心生产环节,全程自主管控生产工艺,最终生产出符合客户标准及客户需求的功率模块。公司核心产品,IGBT模块、SiC MOSFET等功率模块集成度高、内部结构复杂,需在高压、大电流、高温、高速等恶劣工况下稳定运行,对公司的自主设计与生产工艺管控水平提出了极高要求,也彰显了公司模块端自主经营的技术优势。

公司销售以直销模式为主,可深度对接终端客户需求,快速响应定制化开发,技术支持与交付服务,有效提升客户粘性与服务满意度。结合下游客户分布特点,除嘉兴总部外,公司在全国布局多个销售联络处,同时在瑞士设立控股子公司斯达欧洲,负责海外市场开拓和展业。
3. 公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币

主要会计数据和财务指标表,包含营业收入、营业利润、净利润、归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润、经营活动产生的现金流量净额、归属于上市公司股东的净资产、归属于上市公司股东的每股净资产、总资产、总负债、归属于上市公司股东的净资产、归属于上市公司股东的每股净资产、总资产、总负债、归属于上市公司股东的净资产、归属于上市公司股东的每股净资产。

3.2报告期分季度的主要会计数据
单位:元,币种:人民币

报告期分季度的主要会计数据表,包含营业收入、营业利润、净利润、归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润、经营活动产生的现金流量净额、归属于上市公司股东的净资产、归属于上市公司股东的每股净资产、总资产、总负债、归属于上市公司股东的净资产、归属于上市公司股东的每股净资产。

3.3报告期分季度的主要会计数据
单位:元,币种:人民币

报告期分季度的主要会计数据表,包含营业收入、营业利润、净利润、归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润、经营活动产生的现金流量净额、归属于上市公司股东的净资产、归属于上市公司股东的每股净资产、总资产、总负债、归属于上市公司股东的净资产、归属于上市公司股东的每股净资产。

季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用

公司代码:603290 公司简称:斯达半导

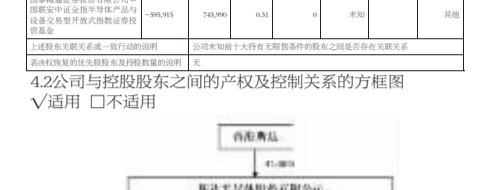
斯达半导体股份有限公司

2025年度报告摘要

4. 股东信息
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况
单位:股

股东信息表,包含普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数、持有特别表决权股份的股东总数、前10名普通股股东持股情况、前10名无限售条件流通股股东持股情况。

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
□适用 □不适用



4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
□适用 □不适用



4.4报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况
□适用 √不适用
5. 公司债券债券信息
□适用 √不适用

第三节 重要事项
1. 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
2025年,公司依托深厚技术积淀与行业领先地位,聚焦核心业务,充分发挥“Fabless+IDM双轮驱动”业务模式优势,同步推动驱动IC、工业级及车规级MCU芯片与现有功率半导体业务深度融合,持续提升核心竞争力与长期发展潜力。
报告期内,公司实现营业收入401,239.53万元,创历史新高,实现归属于上市公司股东的净利润40,523.36万元,较去年同期下降27.2018%,实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润37,715.16万元,较去年同期下降22.61%。
报告期内,公司新能源汽车、新能源发电及储能、变频白色家电行业快速增长,为公司营业收入增长提供核心支撑。同时,公司积极开展AI服务器电源、数据中心、工业机器人、低空/高空飞行器等新应用领域,持续提升产品应用边界,为公司业务增长开辟全新空间。
2. 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
证券代码:603290证券简称:斯达半导公告编号:2026-015

斯达半导体股份有限公司关于召开2025年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
● 股东大会召开日期:2026年5月28日
● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2025年年度股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期:2026年5月28日13:00-13:30
召开地点:浙江省嘉兴市新大路2188号嘉兴斯达微电子有限公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2026年5月28日
至2026年5月28日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即:9:15-9:25、9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》等相关规定执行。
(七)涉及公开发行股票的相关问题
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

会议审议事项表,包含议案名称、议案类别、投票股东类型、是否影响中小投资者利益、是否涉及关联交易、是否涉及重大资产重组、是否涉及股权激励、是否涉及回购、是否涉及分红、是否涉及其他事项。

同时,公司独立董事将在本次股东大会上就2025年度的履职情况进行述职。
一、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股

股东信息表,包含普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东数量、持有特别表决权股份的股东数量、前十名普通股股东持股情况、前十名无限售条件流通股股东持股情况。

1. 各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司于第五届董事会第十五次会议审议通过,详见2026年04月30日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站披露的相关公告。
2. 特别决议议案:议案9、01
3. 对中小投资者单独计票的议案:议案3至议案9
4. 涉及关联股东回避表决的议案:议案6、议案8
应回避表决的关联股东名称:浙江兴得利纺织有限公司
5. 涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端),也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
(三)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会投票的,可以通过任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种投票的第一次投票结果为准。
(四)股东大会对所有议案均表决完毕后才能发表。
四、会议出席对象
(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情形详见下表),并以书面或委托他人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

(二) 公司董事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、会议登记方法
(一) 个人股东持本人身份证、持股凭证和股东账户卡原件办理登记,委托代理人持受托人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件和委托人股东账户卡原件办理登记手续。
(二) 法人股东持法人单位营业执照复印件(加盖公章)、授权委托书(法定代表人签字、盖章)、出席人身份证原件和法人股东账户卡原件办理登记手续。
(三) 登记时间:2026年05月27日(上午9:00-12:00、下午2:00-2:30)
(四) 登记地点:浙江省嘉兴市南湖区科兴路988号斯达半导会议室。
拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以上文件在上述时间、地点现场或通过通讯方式(传真或邮件)办理登记;所有原件均需提供一份复印件;请将上述文件复印件或电子版发送至公司,如通过通讯方式(传真或邮件)办理登记,以2026年05月27日16:00前公司收到为准;不接受电话登记。
六、其他事项
(一) 联系地址:浙江省嘉兴市新大路2188号嘉兴斯达微电子有限公司会议室
(二) 邮政编码:314006
(三) 联系电话:0573-82586699
(四) 传真电话:0573-82588288
(五) 联系地址:investor-relation@powersemi.com
(六) 联系人:李君青
(七) 本次股东大会现场会议会期半天,与会人员的食宿及交通等费用自理。
(八) 拟出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半个小时内到达会议地点。
特此公告。

公司代码:603290 公司简称:斯达半导

斯达半导体股份有限公司

2026第一季度报告

一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码:603290证券简称:斯达半导公告编号:2026-021
斯达半导体股份有限公司关于使用外汇、银行承兑汇票、信用证等方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
斯达半导体股份有限公司(以下简称“斯达半导”或“公司”)于2026年04月29日召开第五届董事会第十五次会议,审议通过了《关于使用外汇、银行承兑汇票、信用证等方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》,同意公司在募投资金投资项目(以下简称“募投项目”)实施期间,根据实际情况并经相关审批程序后使用外汇、银行承兑汇票、信用证等方式支付募投项目所需资金,之后定期以募集资金等额置换,并从募集资金专户划转至自有资金账户,该部分等额置换资金视同募投项目已使用资金。保荐机构中信证券股份有限公司对该事项出具了明确同意的核查意见。现将具体情况公告如下:
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意斯达半导股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2026]396号)注册,公司向特定对象发行可转换公司债券15,000,000张,每张面值为人民币100.00元。本次发行的募集资金总额为人民币1,500,000,000.00元,扣除承销费1,130,000.00元(含增值税)和持续督导费530,000.00元(含增值税)后金额为1,488,340,000.00元(含公司前期使用自有资金支付以及尚未支付的审计及验资费用、律师费用和用于本次发行的信息披露费用等其他发行费用),以上金额已于2026年04月22日汇入公司募集资金专用账户。本次募集资金总额人民币1,500,000,000.00元,扣除各项发行费用(不含税)人民币14,853,773.59元后,实际募集资金净额为1,485,146,226.41元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计并于2026年04月22日出具了信会师报字[2026]第ZA12381号《验资报告》。公司于2026年3月采取了专户存储制度,已全部存放于募集资金专户。

二、募集资金使用情况
根据《斯达半导体股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券募集说明书》,以及实际收到的募集资金净额,本次发行募集资金拟投入以下项目的建设:
单位:万元

募集资金使用情况表,包含项目名称、项目总投资、拟投入募集资金、截至报告期末实际投入募集资金、截至报告期末累计投入募集资金。

注:合计数与各数直接相加之和在尾数上存在差异,系计算中四舍五入造成。
三、使用外汇、银行承兑汇票、信用证等方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的原因
根据《上市公司募集资金监管规则》的相关规定,“募集资金投资项目实施过程中,原则上应当以募集资金直接支付,在支付人员新

证券代码:603290 证券简称:斯达半导
斯达半导体股份有限公司2026年第一季度报告
10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/还原因导致上期发生额
□适用 √不适用
三、其他重要事项
请参见本报告“第三节 重要事项”之“关于本报告期经营情况的其他重要信息”
√适用 □不适用
报告期内,公司实现营业收入6,626.68万元,同比下降74.32%,实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1,679.36万元,同比下降82.49%。
主要原因如下:
(一)报告期内,受下游新能源汽车行业多重因素影响,行业需求短期承压,公司新能源汽车收入较去年同期有所下降。
(二)报告期内,公司固定资产较去年同期大幅增长,对应折旧摊销费用有所上升,公司芯片制造全资子公司嘉兴斯达微电子有限公司多个晶圆线折旧成本仍处于爬坡爬坡期,阶段性运营成本较高。
四、季度财务报表
(一)合并资产负债表
(二)财务报表
合并资产负债表
2026年3月31日
编制单位:斯达半导体股份有限公司

合并资产负债表表,包含流动资产、非流动资产、资产总计、流动负债、非流动负债、负债总计、所有者权益、未分配利润。

编制单位:斯达半导体股份有限公司
单位:元,币种:人民币

合并资产负债表表,包含流动资产、非流动资产、资产总计、流动负债、非流动负债、负债总计、所有者权益、未分配利润。

编制单位:斯达半导体股份有限公司
单位:元,币种:人民币

合并资产负债表表,包含流动资产、非流动资产、资产总计、流动负债、非流动负债、负债总计、所有者权益、未分配利润。

编制单位:斯达半导体股份有限公司
单位:元,币种:人民币

合并资产负债表表,包含流动资产、非流动资产、资产总计、流动负债、非流动负债、负债总计、所有者权益、未分配利润。

编制单位:斯达半导体股份有限公司
单位:元,币种:人民币

合并资产负债表表,包含流动资产、非流动资产、资产总计、流动负债、非流动负债、负债总计、所有者权益、未分配利润。

编制单位:斯达半导体股份有限公司
单位:元,币种:人民币

合并资产负债表表,包含流动资产、非流动资产、资产总计、流动负债、非流动负债、负债总计、所有者权益、未分配利润。

编制单位:斯达半导体股份有限公司
单位:元,币种:人民币

合并资产负债表表,包含流动资产、非流动资产、资产总计、流动负债、非流动负债、负债总计、所有者权益、未分配利润。

公司代码:603290 公司简称:斯达半导

斯达半导体股份有限公司

2026第一季度报告

一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码:603290证券简称:斯达半导公告编号:2026-021
斯达半导体股份有限公司关于使用外汇、银行承兑汇票、信用证等方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
斯达半导体股份有限公司(以下简称“斯达半导”或“公司”)于2026年04月29日召开第五届董事会第十五次会议,审议通过了《关于使用外汇、银行承兑汇票、信用证等方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》,同意公司在募投资金投资项目(以下简称“募投项目”)实施期间,根据实际情况并经相关审批程序后使用外汇、银行承兑汇票、信用证等方式支付募投项目所需资金,之后定期以募集资金等额置换,并从募集资金专户划转至自有资金账户,该部分等额置换资金视同募投项目已使用资金。保荐机构中信证券股份有限公司对该事项出具了明确同意的核查意见。现将具体情况公告如下:
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意斯达半导股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2026]396号)注册,公司向特定对象发行可转换公司债券15,000,000张,每张面值为人民币100.00元。本次发行的募集资金总额为人民币1,500,000,000.00元,扣除承销费1,130,000.00元(含增值税)和持续督导费530,000.00元(含增值税)后金额为1,488,340,000.00元(含公司前期使用自有资金支付以及尚未支付的审计及验资费用、律师费用和用于本次发行的信息披露费用等其他发行费用),以上金额已于2026年04月22日汇入公司募集资金专用账户。本次募集资金总额人民币1,500,000,000.00元,扣除各项发行费用(不含税)人民币14,853,773.59元后,实际募集资金净额为1,485,146,226.41元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计并于2026年04月22日出具了信会师报字[2026]第ZA12381号《验资报告》。公司于2026年3月采取了专户存储制度,已全部存放于募集资金专户。

二、募集资金使用情况
根据《斯达半导体股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券募集说明书》,以及实际收到的募集资金净额,本次发行募集资金拟投入以下项目的建设:
单位:万元

募集资金使用情况表,包含项目名称、项目总投资、拟投入募集资金、截至报告期末实际投入募集资金、截至报告期末累计投入募集资金。

注:合计数与各数直接相加之和在尾数上存在差异,系计算中四舍五入造成。
三、使用外汇、银行承兑汇票、信用证等方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的原因
根据《上市公司募集资金监管规则》的相关规定,“募集资金投资项目实施过程中,原则上应当以募集资金直接支付,在支付人员新

证券代码:603290 证券简称:斯达半导
斯达半导体股份有限公司2026年第一季度报告
10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/还原因导致上期发生额
□适用 √不适用
三、其他重要事项
请参见本报告“第三节 重要事项”之“关于本报告期经营情况的其他重要信息”
√适用 □不适用
报告期内,公司实现营业收入6,626.68万元,同比下降74.32%,实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1,679.36万元,同比下降82.49%。
主要原因如下:
(一)报告期内,受下游新能源汽车行业多重因素影响,行业需求短期承压,公司新能源汽车收入较去年同期有所下降。
(二)报告期内,公司固定资产较去年同期大幅增长,对应折旧摊销费用有所上升,公司芯片制造全资子公司嘉兴斯达微电子有限公司多个晶圆线折旧成本仍处于爬坡爬坡期,阶段性运营成本较高。
四、季度财务报表
(一)合并资产负债表
(二)财务报表
合并资产负债表
2026年3月31日
编制单位:斯达半导体股份有限公司

合并资产负债表表,包含流动资产、非流动资产、资产总计、流动负债、非流动负债、负债总计、所有者权益、未分配利润。

编制单位:斯达半导体股份有限公司
单位:元,币种:人民币

合并资产负债表表,包含流动资产、非流动资产、资产总计、流动负债、非流动负债、负债总计、所有者权益、未分配利润。

编制单位:斯达半导体股份有限公司
单位:元,币种:人民币

合并资产负债表表,包含流动资产、非流动资产、资产总计、流动负债、非流动负债、负债总计、所有者权益、未分配利润。

编制单位:斯达半导体股份有限公司
单位:元,币种:人民币

合并资产负债表表,包含流动资产、非流动资产、资产总计、流动负债、非流动负债、负债总计、所有者权益、未分配利润。

编制单位:斯达半导体股份有限公司
单位:元,币种:人民币

合并资产负债表表,包含流动资产、非流动资产、资产总计、流动负债、非流动负债、负债总计、所有者权益、未分配利润。

编制单位:斯达半导体股份有限公司
单位:元,币种:人民币

合并资产负债表表,包含流动资产、非流动资产、资产总计、流动负债、非流动负债、负债总计、所有者权益、未分配利润。

编制单位:斯达半导体股份有限公司
单位:元,币种:人民币

合并资产负债表表,包含流动资产、非流动资产、资产总计、流动负债、非流动负债、负债总计、所有者权益、未分配利润。

公司代码:603290 公司简称:斯达半导

斯达半导体股份有限公司

2026第一季度报告

一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码:603290证券简称:斯达半导公告编号:2026-021
斯达半导体股份有限公司关于使用外汇、银行承兑汇票、信用证等方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
斯达半导体股份有限公司(以下简称“斯达半导”或“公司”)于2026年04月29日召开第五届董事会第十五次会议,审议通过了《关于使用外汇、银行承兑汇票、信用证等方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》,同意公司在募投资金投资项目(以下简称“募投项目”)实施期间,根据实际情况并经相关审批程序后使用外汇、银行承兑汇票、信用证等方式支付募投项目所需资金,之后定期以募集资金等额置换,并从募集资金专户划转至自有资金账户,该部分等额置换资金视同募投项目已使用资金。保荐机构中信证券股份有限公司对该事项出具了明确同意的核查意见。现将具体情况公告如下:
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意斯达半导股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2026]396号)注册,公司向特定对象发行可转换公司债券15,000,000张,每张面值为人民币100.00元。本次发行的募集资金总额为人民币1,500,000,000.00元,扣除承销费1,130,000.00元(含增值税)和持续督导费530,000.00元(含增值税)后金额为1,488,340,000.00元(含公司前期使用自有资金支付以及尚未支付的审计及验资费用、律师费用和用于本次发行的信息披露费用等其他发行费用),以上金额已于2026年04月22日汇入公司募集资金专用账户。本次募集资金总额人民币1,500,000,000.00元,扣除各项发行费用(不含税)人民币14,853,773.59元后,实际募集资金净额为1,485,146,226.41元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计并于2026年04月22日出具了信会师报字[2026]第ZA12381号《验资报告》。公司于2026年3月采取了专户存储制度,已全部存放于募集资金专户。

二、募集资金使用情况
根据《斯达半导体股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券募集说明书》,以及实际收到的募集资金净额,本次发行募集资金拟投入以下项目的建设:
单位:万元

募集资金使用情况表,包含项目名称、项目总投资、拟投入募集资金、截至报告期末实际投入募集资金、截至报告期末累计投入募集资金。

注:合计数与各数直接相加之和在尾数上存在差异,系计算中四舍五入造成。
三、使用外汇、银行承兑汇票、信用证等方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的原因
根据《上市公司募集资金监管规则》的相关规定,“募集资金投资项目实施过程中,原则上应当以募集资金直接支付,在支付人员新

证券代码:603290 证券简称:斯达半导
斯达半导体股份有限公司2026年第一季度报告
10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/还原因导致上期发生额
□适用 √不适用
三、其他重要事项
请参见本报告“第三节 重要事项”之“关于本报告期经营情况的其他重要信息”
√适用 □不适用
报告期内,公司实现营业收入6,626.68万元,同比下降74.32%,实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1,679.36万元,同比下降82.49%。
主要原因如下:
(一)报告期内,受下游新能源汽车行业多重因素影响,行业需求短期承压,公司新能源汽车收入较去年同期有所下降。
(二)报告期内,公司固定资产较去年同期大幅增长,对应折旧摊销费用有所上升,公司芯片制造全资子公司嘉兴斯达微电子有限公司多个晶圆线折旧成本仍处于爬坡爬坡期,阶段性运营成本较高。
四、季度财务报表
(一)合并资产负债表
(二)财务报表
合并资产负债表
2026年3月31日
编制单位:斯达半导体股份有限公司

合并资产负债表表,包含流动资产、非流动资产、资产总计、流动负债、非流动负债、负债总计、所有者权益、未分配利润。

编制单位:斯达半导体股份有限公司
单位:元,币种:人民币

合并资产负债表表,包含流动资产、非流动资产、资产总计、流动负债、非流动负债、负债总计、所有者权益、未分配利润。

编制单位:斯达半导体股份有限公司
单位:元,币种:人民币

合并资产负债表表,包含流动资产、非流动资产、资产总计、流动负债、非流动负债、负债总计、所有者权益、未分配利润。

编制单位:斯达半导体股份有限公司
单位:元,币种:人民币

合并资产负债表表,包含流动资产、非流动资产、资产总计、流动负债、非流动负债、负债总计、所有者权益、未分配利润。

编制单位:斯达半导体股份有限公司
单位:元,币种:人民币

合并资产负债表表,包含流动资产、非流动资产、资产总计、流动负债、非流动负债、负债总计、所有者权益、未分配利润。

编制单位:斯达半导体股份有限公司
单位:元,币种:人民币

合并资产负债表表,包含流动资产、非流动资产、资产总计、流动负债、非流动负债、负债总计、所有者权益、未分配利润。

编制单位:斯达半导体股份有限公司
单位:元,币种:人民币

合并资产负债表表,包含流动资产、非流动资产、资产总计、流动负债、非流动负债、负债总计、所有者权益、未分配利润。